

Peningkatan kualitas pada proses moulding dengan menggunakan metode response surface untuk mengurangi problem wire sweep = Quality improvement on moulding process by using response surface method for decreasing wire sweep problem

Isprianti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20332193&lokasi=lokal>

Abstrak

Terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses Moulding, yang berimbas pada menurunnya kualitas suatu produk, salah satunya adalah permasalahan Wire Sweep. Permasalahan Wire Sweep ini jika tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan pada saat produk diimplementasikan dan bisa membahayakan konsumen atau pemakai. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas proses Moulding tersebut yaitu dengan mengurangi terjadinya permasalahan Wire Sweep. Dengan terlebih dahulu mencari faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya permasalahan Wire Sweep. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah Temperature, Transfer Time dan Delay Time. Untuk mengetahui kombinasi optimal parameter dari faktor-faktor tersebut digunakan Response Surface Method (RSM). Hasil dari penelitian ini dapat direkomendasikan kepada perusahaan semikonduktor tersebut dimana kombinasi parameter yang optimal yang mengurangi terjadinya permasalahan Wire Sweep adalah Temperature sebesar 180.89o celcius, Transfer Time selama 7.84 detik dan Delay Time selama 6.41 detik.

.....There are many kinds of problem that happened on Moulding process that effect to quality loss, one of problem in Moulding process is Wire Sweep. If this Wire Sweep poble never been solved properly, can create defect during implementation on customer. One action that can be done for improving the quality on Moulding process ia by decreasing the occurenc of Wire Sweep problem. Initial step that can be choosed is by looking for the significant factor that affect to Wire Sweep occurence. Those factors are Temperature, Transfer Time and Delay Time. To find out the optimum combination of Moulding parameter, Response Surface Method (RSM) can be used. The research result can be recommended to related semiconductor company. Those optimum parameter value Temperature with 180.89o Celsius, Transfer Time with 7.84 second and Delay Time with 6.41 second.